

PLACAS INAPRECO PARA ENTREPISOS Y CUBIERTAS

Las placas INAPRECO han sido diseñadas para reemplazar a la losa maciza de hormigón armado, obligatoria en Chile para todo edificio elevado y cuya función es transmitir las cargas "activas" de los pisos a las vigas y pilares, sirviendo además como base rígida a los pavimentos.

La placa se compone de viguetas precomprimidas, fabricadas en taller, perfectamente fraguadas y ensayadas individualmente y que se remiten a la obra listas para recibir carga.

Su perfil es semejante a una doble T, o mejor, al de un riel de vía. La aleta inferior está diseñada para apoyar las bovedillas o casetones que rellenan el conjunto.

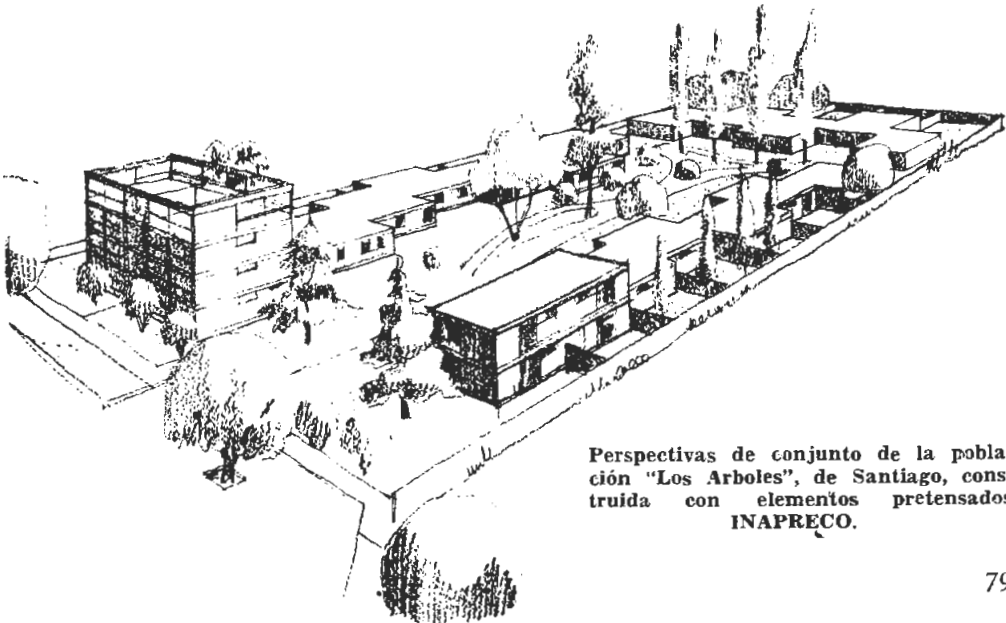
El montaje de las placas no precisa encofrado alguno ni mortero de adherencia entre los elementos.

Sobre el perfil curvo de las bovedillas, la superficie se enrasa con una capa de hormigón de gravilla de 3 a

4 cm. de espesor. Si la placa ha de utilizarse como plano rigidizante horizontal de la estructura, debe disponerse una malla cuadriculada de barras redondas de acero para construcción soldada o amarrada cuyo peso es del orden de 2 a 2,5 Kg/m².

El espesor total de la placa, incluido su relleno superior puede ser de 20 o 25 cm., según el perfil de vigueta elegido lo que dependerá de los momentos máximos solicitantes. Las viguetas de serie destinadas a entresijos pueden entregarse hasta 6,50 m. de luz. Las viguetas para cubiertas pueden salvar hasta 7,00 m.

La placa así construida es atérmica y posee un alto índice de absorción del sonido. Poseyendo todas las ventajas del hormigón armado, su peso propio es inferior al que desplaza una losa convencional para la misma luz y su velocidad de montaje no admite comparación alguna.



Perspectivas de conjunto de la población "Los Arboles", de Santiago, construida con elementos pretensados INAPRECO.